This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

刑药物(4)

(B)20300540158

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公園委号

特開平7-126827

(43)公開日 平成7年(1995)5月18日

(51) Int.CL.

放射記号 广内整理器号

FΙ

技術表示箇所

C23C 4/04 4/10

審査請求 有 耐水項の数2 FD (全 5 頁)

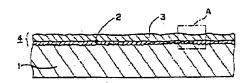
(21)出版番号 特別平5-294327 (71)出版人 000094732 株式会社日本アルミ 大阪府大阪市淀川区三国本町 3 丁目 9 番39 号 株式会社日本アルミ 大阪府大阪市淀川区三国本町 3 丁目 9 番39 号 株式会社日本アルミ内 (72)発明者 全気 昭一 大阪府大阪市淀川区三国本町 3 丁目 9 番39 号 株式会社日本アルミ内 (74)代理人 弁理士 青山 英 (外1名)

(54) 【発明の名称】 金属表面の複合皮膜及びその形成方法

(57) 【要約】

【目的】 セラミック溶射反應のみに基づく性質を改善 し又は改質することのできる金属表面の複合皮膜を提供 することである。

[構成] 金属(基板1)要面に形成された下地溶射皮 源2と下地溶射皮膜2上に形成されたセラミック溶射皮 度3とからなる複合皮膜4において、下地溶射皮膜2が 窒化チタンを主成分とすることを特徴としている。



【特許請求の範囲】

[請求項1] 金属級面に形成された下地溶射皮膜と下地溶射皮膜上に形成されたセラミック溶射皮膜とからなる複合皮膜において、下地溶射皮膜が窒化チタンを主成分とすることを特徴とする金属表面の複合皮膜。

【旗求項2】 金属表面に下地溶射皮膜を介してセラミック溶射皮膜を形成して、両溶射皮膜からなる複合皮膜を形成する方法において、チタンを大気中で溶射して下地溶射皮膜を形成することを特徴とする金属表面の複合皮膜の形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えばアルミニウム等の金属の表面に形成された下地溶射反展及びセラミック溶射反度からなる複合皮質、及びその形成方法に関するものである。

[0002]

【従来技術及びその問題点】金属表面にセラミック溶射 度度を形成する場合には、金属とセラミックとの熱度張 係数の差を緩和して両者の密治性を向上させるために、 両者の中間の慇懃張係数を有する材料からなる下地溶射 度度を両者間に形成することが、一般に行なわれてい る。そして、従来、下地溶射度度は金属からなるもので あった。

【0003】ところで、金属表面にセラミック溶射皮膜を形成する目的は、絶縁性の向上、耐熱性の向上等、現 なある。例えば、絶縁性の同上を図る場合には、所望の 地縁性を呈する厚さ及び材料のセラミック溶射皮膜を形成する。しかし、形成できるセラミック溶射皮膜の厚さには上級があるため、絶縁性の向上にも限界があった。このような限界は、絶縁性に限らず、セラミック溶射皮膜に基づく他の性質の発現においても同様であった。

[0004]

【発明の目的】本発明者は、下地溶射皮質の材質に著目し、これを変えることにより、下地溶射皮質の性質をセラミック溶射皮膜に基づく性質に相加的又は相乗的に作用させることを考えた。即ち、本発明は、セラミック溶射皮膜のみに基づく性質を改善し又は改質することのできる金属表面の複合皮質を提供することを目的とし、また、そのような複合皮質を形成することのできる方法を提供することを目的とする。

[0005]

【目的を選成するための手段】本発明の金属表面の複合 皮膜は、金属表面に形成された下地溶射反膜と下地溶射 皮膜上に形成されたセラミック溶射皮膜とからなる複合 皮膜において、下地溶射皮膜が窒化テタンを主成分とす ることを特徴としている。

【0006】本発明の金属表面の複合及膜の形成方法は、会風表面に下地溶射皮膜を介してセラミック溶射皮膜を形成して、両溶射皮膜からなる複合皮膜を形成する方法において、チタンを大気中で溶射して下地溶射反膜を形成することを特徴としている。

[0007]

【作用】本発明の金属表面の複合皮質においては、下地溶射皮質の大部分が窒化チタンからなっているので、下地溶射皮膜はセラミックとしての性質を発現することとなる。従って、複合皮膜の性質は、セラミック溶射皮膜のセラミックとしての性質が作用したものとなる。

【0008】 チタンは大気中にて反応して堕化チタンになりやすいので、本発明の金属表面の複合皮膜の形成方法によれば、下地溶射皮膜の大部分は墜化チタンからなるものとなる。

[00001

【実施例】図1は本発明の方法により形成された複合反 度を示す断面圏である。図において、1はアルミニウム 部材からなる基板、2は下地溶射皮膜、3はセラミック 溶射支膜である。複合皮膜4は、両溶射皮膜2、3からなっている。基板1のアルミニウム部材としてはA5052を用い、セラミック溶射皮膜3のセラミックとしてはホワイトアルミナを用いた。また、基板1の厚さは6mm、下地溶射皮膜2の厚さは50~100μm、セラミック溶射皮膜3の厚さは200~300μmとした。【0010】次に、形成方法について説明する。基板1 表面に、プラスト処理後、独定が10~44μmの続チタン粉末をプラズマ溶射して下地溶射皮膜2を形成した。プラスト処理は、アルミナグリッドを用いて行なった。アルミナグリッドとしては具体的には、「アランダム#24」を用いた。

【0011】次に、下地溶射皮膜2上に、粒度が10~45μmのホワイトアルミナをブラズマ溶射してホワイトアルミナからなるセラミック溶射皮膜3を形成した。 【0012】なお、下地溶射皮膜2及びセラミック溶射 皮膜3を形成する際の各プラズマ溶射は、出力60kw 数の菌産のプラズマ溶射装置を用いて、表1に示す条件 で行なった。

[0013]

【表 1】

特開平07-126827

| | 下地溶射皮膜 | セラミック海射皮膜 |
|---------------|-------------|-------------|
| | の場合 | の場合 |
| 出力 (電流(A)- | · | |
| 電圧(V)) | 1000A-34V | |
| プラズマガス(Aェ)量 | 60 £/min | |
| ミックスガス(N 2)量 | 0 | |
| パウダーガス(Ar)量 | 5 8/min | |
| パウダー供給量 | 0. 8 kg·f/h | 3. 0 kg-f/h |
| 溶射距離(mm) | 120mm | 70 m.m. |

(3)

【0014】こうして、アルミニウム部材からなる基板 1表面に、下地溶射皮膜2を介してセラミック溶射皮膜 3が形成された。即ち、複合皮膜4が形成された。四2 は四1のA部の拡大写真である。

【0015】上記形成方法において、下地溶射皮膜2を形成する際に、純チタンは大気中にて反応して殆んどが 壁化チタンに変わる。このため、下地溶射皮度2は大部分が窒化チタンからなっており、純チタンは少量である。図3は下地溶射皮膜2の組成を示すX環回折図である。図3からわかるように、選化チタンと純チタンの含有割合は約5:1である。

【0016】 空化チタン及び純チタンの熱感強係数は、アルミニウムとアルミナの間に位置している。このため、セラミック溶射皮膜3の基板1に対する密着性は、下地溶射皮膜2を介することによって同上している。密着強度は、具体的には3kg・f/mm²であった。特に、チタンはアルミニウムと反応するので、下地溶射皮膜2の基板1に対する密着性は向上している。

【0017】セラミック溶射皮膜3は、セラミックであるホワイトアルミナからなっているため、絶縁性を有している。下地溶射皮膜2も、大部分がセラミックである窒化チダンからなっているため、絶縁性を有している。従って、複合皮膜4は、セラミック溶射皮膜3のみに基づく絶縁性よりも高い絶縁性を有することとなる。即ち、セラミック溶射皮膜3のみに基づく絶縁性は改善されたこととなる。

【〇〇13】以下に、絶縁破壊試験の方法及びその結果

を示す、結果から、絶縁性が改善されていることがわかる。

<u> 经存款 医试验</u>

・種類:気中試験

試験方法:JIS-C2110(段階破壊試験)に準 ピエ

可加周波费:800Hz(方形波)

平板-平板電極(め25)

結果

| | 能暴破機電圧気中(KV) | |
|------------|--------------|--|
| 使来例 | 3. D | |
| 本实施例 | 7. D | |

なお、従来例は、下地溶射皮膜2としてN:・A!合金 を用いた。

【0019】また、絶縁性以外に、耐熱性、耐高温度食等の特性を改善することができる。

【0020】なお、下地溶射皮膜2及びセラミック溶射 皮膜3を形成する際の各プラズマ溶射の条件を表2又は 表3に示すようにしても、上記突施例と略同じ複合皮膜 4が得られた。

[0021] [表2]

| | 下地溶射皮膜 | セラミック溶射皮膜 |
|--------------|------------|-------------|
| | の場合 | の場合 |
| 出力 (電流(A)~ | | |
| 電圧(V)) | 900A-44.5V | |
| プラズマガス(Ar)登 | 60 4/min | |
| ミックスガス(N2)量 | 7 2/min | 0 |
| パウダーガス(Aェ)量 | 5 4/m i n | |
| パウダー供給量 | 0. 8kg·f/h | 3. 0 kg·f/h |
| 溶射距離(mm) | 120mm | 70 mm |

[0022]

【表3】

特朗平07-126827

| • | 下地溶射皮膜 | セラミック溶射皮膜 |
|-------------|---------------|-------------|
| | の場合 | の場合 |
| 出力 (電流(A)- | | · |
| 電圧(V)) | 800A-50V | |
| プラズマガス(Ar)量 | 60 4/min | |
| ミックスガス(N1)量 | 16 2/min | 0 |
| パラダーガス(Ar)量 | 5 4/min | |
| パウダー供給量 | 0. 8 kg · f/h | 3. 0 kg-f/h |
| 溶射距離(四四) | 120mm | 70 mm |

【0023】また、基板1の金属としては、例えば、複々の鉄鋼材料、飼、関合金、チタン、チタン合金、ニッケル基合金、コバルト基合金等を用いてもよく、セラミック溶射反翼3のセラミックとしては、例えば、ジルコニア、チタニア、スピネル、イットリア等を用いてもよい。

[0024]

【免明の効果】以上のように本発明の金属基面の複合皮 属によれば、下地溶射皮膜2の大部分が受化チタンから なっているので、下地溶射皮膜2にセラミックとしての 性質を持たせることができる。従って、複合皮膜4の性 質を、セラミック溶射皮膜3のセラミックとしての性質 に、下地溶射反膜2のセラミックとしての性質 せてなるものにでき、セラミック溶射皮膜3のみに基づ く性質を改善し又は改質することができる。例えば、複 合皮膜4に、セラミック溶射皮膜3のみによる絶縁性よ り高い総縁性を持たせることができ、更には、耐熱性、 耐高温度食等の特性を改善することができる。

【0025】また、本築明の金重表面の複合皮膜の形成 方法によれば、大部分が堕化チタンからなる下地溶射皮 膜2を容易且つ確実に形成できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の方法により形成された複合皮膜を示す断面図である。

【図2】 結晶の構造を示す図面に代わる写真であって、図1の一部を拡大して示す。

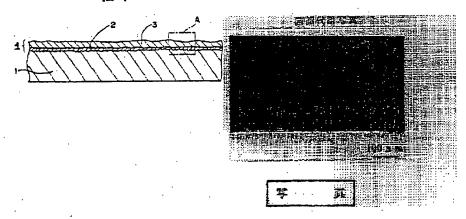
【図3】 下地溶射皮膜の組成を示す X線回折図であ

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 下地溶射皮膜
- 3 セラミック溶射皮膜
- 4 複合反瞑

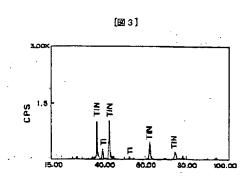
[图1]

[图2]



(5)

特路平07-126827



5